

tesa® HAF 8440

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



เทป HAF फिल्मที่ติดโดยการกระตุ้นด้วยความร้อน สีขุ่น หนา 40 ไมครอน

รายละเอียดสินค้า

tesa® HAF 8440 เป็นฟิล์มกาวกระตุ้นด้วยความร้อน กาวสองหน้า โปร่งใส ประกอบด้วย thermoplastic copolyamide

คุณสมบัติพิเศษ:

- การยึดติดโมดูลชิพเชื่อถือได้
- เหมาะสำหรับ PVC, ABS, PET และ PC การ์ด
- สามารถใช้การได้ดีกับสายการผลิตฝังชิพทั่วไป
- ไม่สามารถมองเห็นบน assembled card

สาขาการใช้งาน

tesa® HAF 8440 ได้รับการออกแบบเป็นพิเศษสำหรับการฝังชิพโมดูลลงในสมาร์ตการ์ด

ข้อมูลทางเทคนิค (ค่าเฉลี่ย)

ค่าในส่วนนี้ถือเป็นตัวแทนหรือเป็นแบบทั่วไปเท่านั้น และไม่ควรรู้เพื่อวัตถุประสงค์จำเพาะเจาะจง.

โครงสร้างผลิตภัณฑ์

• ตัวเทป	none	• ประเภทของแผ่นลอก	glassine
• ประเภทของกาว	copolyamide	• ความหนารวม	40 µm

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

• แรงยึดเกาะ (หลัก)	7 N/mm²
---------------------	---------

ข้อมูลเพิ่มเติม

คำแนะนำทางเทคนิค:

ค่าต่างๆ ต่อไปนี้เป็นคำแนะนำสำหรับพารามิเตอร์ของเครื่องจักรที่จะใช้เบื้องต้น

โปรดทราบว่าค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับชนิดของเครื่อง รวมทั้งวัสดุที่ใช้สำหรับตัวการ์ด ชิปโมดูล และข้อกำหนดของลูกค้า

1. การติดเคลือบเบื้องต้น:

ช่วงการติดเบื้องต้น เทปกาวได้รับการเคลือบติดบนสายพานโมดูล ขั้นตอนนี้สามารถทำได้แบบอินไลน์หรือออฟไลน์

ขั้นตอนเคลือบติดเบื้องต้นนี้ไม่ส่งผลกระทบต่ออายุการเก็บรักษาของเทป

การตั้งค่าเครื่องจักร:

- อุณหภูมิ 130 - 140 °C
- แรงกดทับ 2-3 บาร์
- เวลา 2.5 ม./นาที่

2. การฝังโมดูล:

สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=8440>

tesa® HAF 8440

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ข้อมูลเพิ่มเติม

ระหว่างการผลิต โมดูลที่เคลือบติดเทปแล้วจะถูกDie-cut จากสายพานโมดูลและถูกวางไว้ในหลุมของบัตเตอร์และติดอย่างถาวรเข้ากับตัวบัตเตอร์ด้วยความร้อนและแรงกด สำหรับขั้นตอนนี้ การจัดการที่แน่นอนในชั้นนี้ขึ้นอยู่กับชนิด implanting line ที่ใช้ สามารถใช้ทั้งแบบกดขึ้นตอนเดียวและแบบกดอัดหลายๆครั้ง ปัจจุบันวิธีแบบกดอัดหลายๆครั้งเป็นแบบที่ใช้กันโดยทั่วไป

การตั้งค่าเครื่อง - กดอัดขึ้นตอนเดียว:

- อุณหภูมิ 180–220 °C
- แรงกด 65 N/โมดูล
- เวลา 1.5 วินาที

กระบวนการกดอัดหลายๆครั้ง(การกดอัดด้วยความร้อน 2 ครั้งหรือมากกว่า) - การตั้งค่าเครื่อง:

- อุณหภูมิ 180 – 220 °C
- แรงกด 65 N/โมดูล
- เวลา 2 x 0,7 วินาที / 3 x 0.5 วินาที

¹ อุณหภูมิตามที่วัดภายในเครื่องกดอัดด้วยความร้อน สำหรับวัสดุบัตเตอร์ที่แตกต่างกันมีการตั้งค่าอุณหภูมิที่แตกต่างกัน มีแนะนำดังนี้:

- *PVC 180 - 190 °C
- *ABS 180 - 190 °C
- *PET 190 - 200 °C
- *PC 200 - 220°C

สำหรับการใช้งานอื่น ๆ นอกเหนือจากการฝังชิปโมดูล ควรใช้การตั้งค่าเครื่องที่แตกต่างกัน

ค่าความแข็งแรงของการติดได้รับการทดสอบภายใต้สภาวะห้องปฏิบัติการมาตรฐาน

ค่าที่ได้ได้รับการันตีจากการทดสอบด้วยจำนวนจำกัดในแต่ละชุดการผลิต (วัสดุ: ชิ้นงานทดสอบ Etchedอะลูมิเนียม/สภาวะการติด: อุณหภูมิ = 120 °C; p = 10 บาร์; เวลา = 8 นาที)

สภาพการเก็บรักษาเป็นไปตามมาตรฐานอายุการใช้งาน tesa® HAF

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซา พิสจัน ให้ เห็น ถึง ความ ประทับ ใจ ใน คุณภาพ ของสินค้า มา เป็น เวลา ช้า นาน ผ่าน เงื่อนไข ด้าน อุปสงค์ และ ผลิตภัณฑ์ เท ซา อยู่ ภายใต้ การ ควบคุม อย่าง เคร่งครัด สม่าเสมอ โดย ข้อมูล ทาง ด้าน เทคนิค และ ตัว เลข ทั้ง หมด ที่ ได้ กล่าวถึงข้างต้น นั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซา ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็น ข้อมูลจำเพาะของสินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดแจ้งหรือโดยนัย แต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆ โดยนัยทั้ง ใน ด้าน การ ค่า หรือ สำหรับ วัตถุ ประสงค์ อย่าง ใด เป็น การ เฉพาะ ผู้ ใช้ จะ ต้อง รับ ผิด ชอบ ใน การ ตัดสิน ใจ ใช้ ผลิตภัณฑ์ ให้ เหมาะ สม กับ วัตถุ ประสงค์ และ การ ใช้งาน ของ ผู้ ใช้ เอง ถ้า หาก ท่าน มี ข้อ สงสัย ประการ ใด ผู้เชี่ยวชาญ ของ ทาง เท ซา ยินดี ให้ คำ ปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=8440>